KM-S 晶圆超临界干燥系统

晶圆与微结构干燥 · 自动化导入评估

面向 8 / 12 英寸晶圆与微结构的超临界 CO_2 干燥研究，以及洁净环境下的设备导入评估。对于湿法处理后结构变形、粘连或完整性问题，可结合晶圆结构、已有制程和评价方法讨论干燥环节的适用性。



设备能力与配置

晶圆承载与开盖：13 英寸级高压仓配合晶圆垂直提篮；自动釜盖采用双杆同步升降与周向锁紧，配置位置检测和安全联锁。

洁净流路：采用 316L 接液部件，过滤等级结合晶圆工艺的洁净要求配置。

批次数据与接口：记录配方、温压曲线、状态及报警；上下料信号与 MES 对接按项目确定。

参考规格

晶圆适配	8 / 12 英寸；片数、间距及治具按项目确认
仓体形式	13 英寸级高压仓，自动升降釜盖
工作压力	0-3500 psi（约 24.1 MPa）
工作温度	-30 至 80 °C
接液材料	316L
外形参考	约 180 × 124 × 128 cm

适用范围与配置边界

> 晶圆治具、片数、间距和过滤配置需结合具体制程确认。对接自动化产线前，应评估上下料、洁净要求及数据接口；方形基板等特殊载体单独进行工程评估。供货配置与安装空间按项目确认。 实际效果与原料或样品、前处理和运行条件有关。

400-009-7890

www.kimax-cpd.com

资料依据：2026 年 9 月《超临界设备产品手册》，产品手册第 12-13、22 页。最终规格以对应版本规格书、技术协议与铭牌为准；尺寸不含操作及检修空间。本资料不替代操作手册。